

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2024年6月27日(27.06.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/135469 A1

(51) 国際特許分類:  
G06K 19/077 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/044486

(22) 国際出願日: 2023年12月12日(12.12.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2022-205219 2022年12月22日(22.12.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社 東芝 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) [JP/JP]; 〒1050023 東京都港区芝浦一丁目1番1号 Tokyo (JP). 東芝インフラシステムズ株式会社 (TOSHIBA INFRASTRUCTURE SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION) [JP/JP]; 〒2120013 神奈川県川崎市幸区堀川町7番地34 Kanagawa (JP).

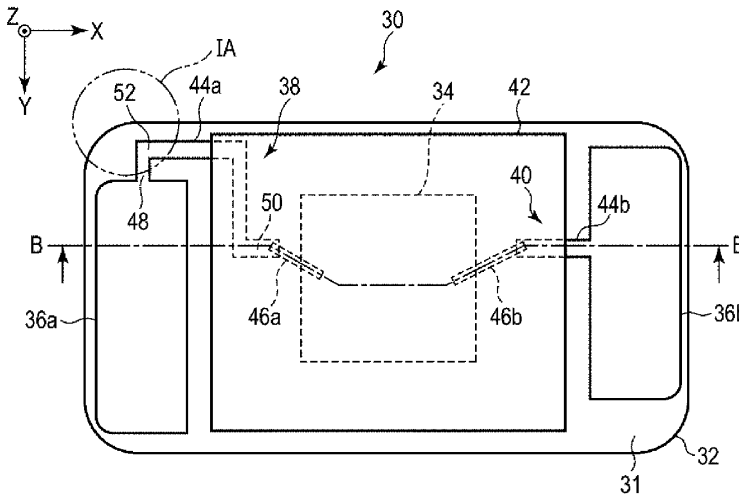
(72) 発明者: 室原 勝 (MUROHARA, Masaru); 〒2108541 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リパーク 東芝自動機器システムサービス株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人スズエ国際特許事務所 (S & S INTERNATIONAL PPC); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目12番9号 スズエ・アンド・スズエビル Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: WIRELESS IC MODULE, WIRELESS IC CARD, AND METHOD FOR MANUFACTURING WIRELESS IC MODULE

(54) 発明の名称: 無線ICモジュール、無線ICカード、及び無線ICモジュールの製造方法



(57) Abstract: A wireless IC module according to an embodiment comprises: a base substrate, a pair of antenna terminals that are formed on the base substrate and connected to an antenna, an IC chip placed on the base substrate, a first connecting wire that connects the IC chip and one of the pair of antenna terminals, and a second connecting wire that connects the IC chip and the other of the pair of antenna terminals. The base substrate has an identification region where a notch for identification of a defective item is formed, and the first connecting wire is provided across the identification region such that the first connecting wire is cut when the notch is formed.

[続葉有]

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,  
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

---

(57) 要約: 実施形態に係る無線 IC モジュールは、ベース基板と、前記ベース基板に形成され、アンテナが接続される一対のアンテナ端子と、前記ベース基板に実装された IC チップと、前記 IC チップと前記一対のアンテナ端子のうち一方のアンテナ端子とを接続する第 1 接続配線と、前記 IC チップと前記一対のアンテナ端子のうち他方のアンテナ端子とを接続する第 2 接続配線と、を備え、前記ベース基板は、不良品識別用の切欠が形成される識別領域を有し、前記第 1 接続配線は、前記切欠が形成された際に切断されるように前記識別領域を横断して設けられている。